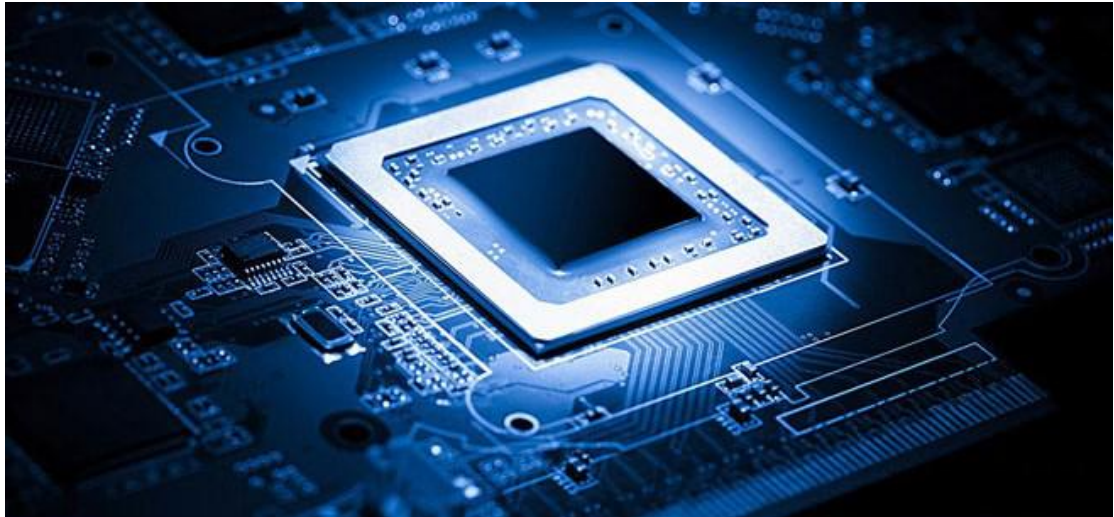


智能铜厚测量，正业科技提供专业解决方案

随着技术工艺的创新和提升，线路板从单层发展到双面板、多层板，并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展，保持着强大的生命力。



线路板因为层数等因素而导致厚度不一，对铜厚检测需求也会有所不同。目前，市面上使用最多的方法是通过面铜测厚仪进行正反面同时测量，精准可靠，优势突出。

但问题在于，使用正反面同时测量的模式去检测薄板，容易造成板面的损伤，而且数据不稳定，精度偏差太大。因此，正业科技经过专业团队的不懈努力，开发了两种机型，分别满足薄厚板的不同需求。

正业科技

在线铜厚测试仪

解决行业痛点，保障产品品质

(图标) (图标) (图标)
高精度 高效率 双面检测

(图标) (图标) (图标)
连线检测 智能选点 MSA 对接



专业方案

满足不同厚度检测需求

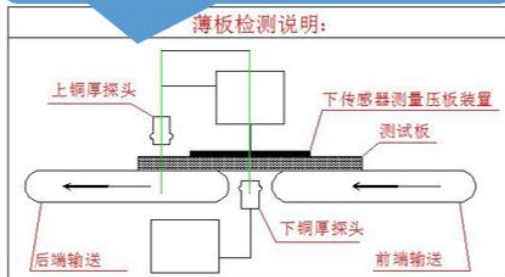
根据不同板材的厚度，需要两种不同类型的结构，分别满足铜厚检测要求。

根据不同板材的厚度，需要两种不同类型的结构，分别满足铜厚检测要求。

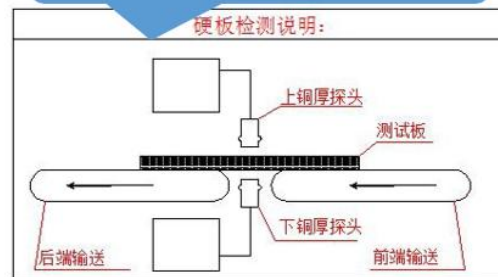
硬板型号：TH22（板厚0.15-8mm）

薄板型号：TH15（板厚0.03-8mm）

薄板上下探头，正反面非镜像测量



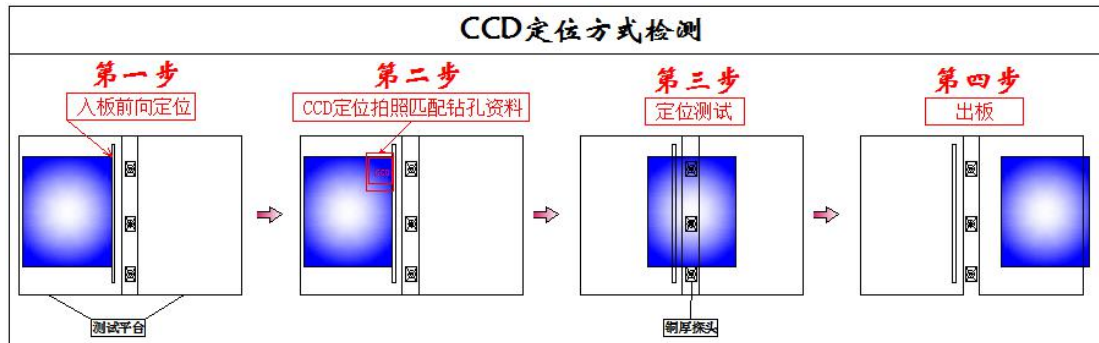
硬板上下探头，正反面镜像测量



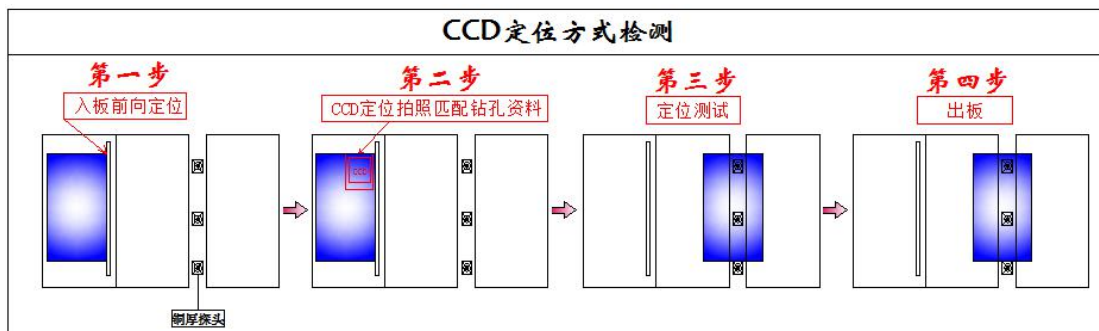
检测流程

高效检测 操作简便

TH22-硬板检测流程



TH15-薄板检测流程



选型指南

针对需求快速选择

测量类型

- 适用于 PCB 减铜生产线前后工序的面铜厚度检测。
- 适用于 PCB 电镀铜后的面铜厚度检测。
- 适用于 PCB 基材铜箔的面铜厚度检测。

空间需求 硬板 > 1.5M, 薄板 > 2.2M (不满足: 采用离线方式)。

效率能力 效率能力 硬板 > 0.15mm: 18点 4-6pc/min 6点 > 8pc/min; 薄板效率 2-3pc/min。

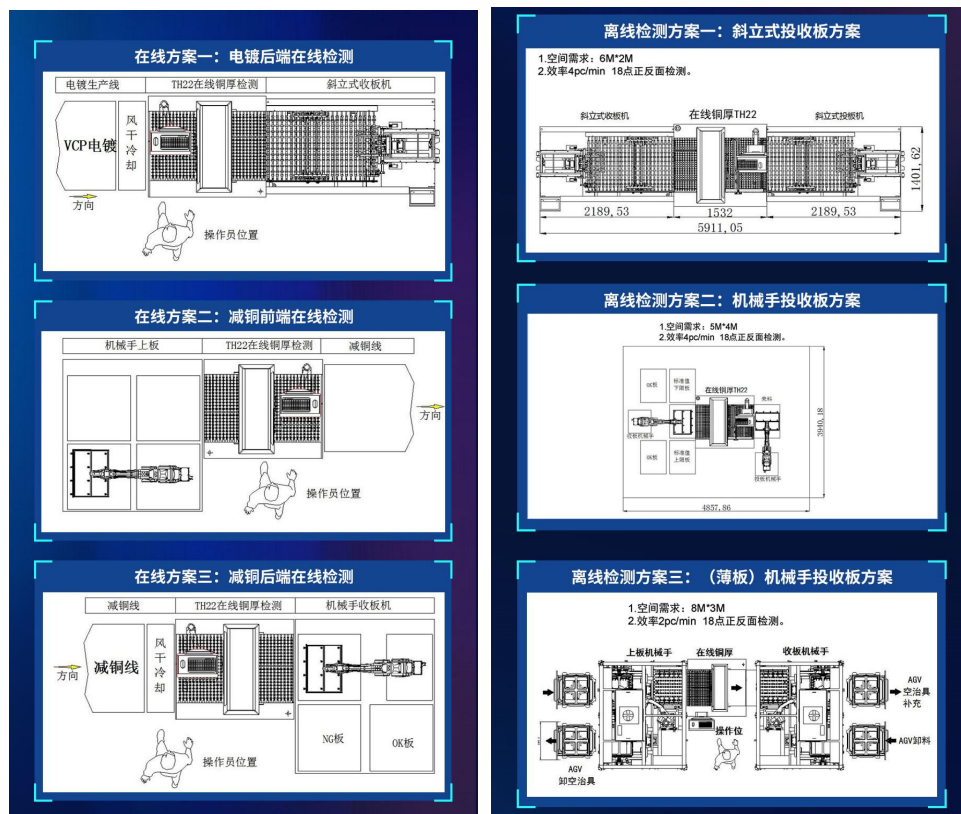
精度能力 铜厚 0.1-120 μ m: 线性/重复性精度 3-5%。

型号评估 板厚 < 0.15mm: TH15 适用通孔/盲孔板-调钻孔资料选点。
板厚 > 0.15mm: TH22 适用通孔/盲孔板-调钻孔资料选点。

在线/离线解决方案

全方位满足个性化需求

针对不同的检测需求, 正业科技推出六种高性价比的在线/离线解决方案, 在线分别为电镀后段在线检测、减铜前端在线检测、减铜后段在线检测, 离线分别为斜立式投收板方案、机械手投收板方案以及(薄板)机械手投收板方案, 助力企业降低人力生产成本, 提升生产效率。





广东正业科技股份有限公司

地址:广东东莞松山湖南园路6号

电话:0769-889805064

产品优势

集齐技术、行业等众多优势

智能检测: 扫描成像智能找点, 免去人工介入及人力。

专利保护: 行业领先, 该机型专利总数>15 件。

技术优势: 可定制兼容满足薄板和厚板 (0.030-6mm)。

行业优势: 鹏鼎、深南、五株、景旺、美维正式投产检测应用经验。

配件优势: 德国菲希尔探头寿命高, 销售及售后>10 年。

独家优势: 高温补偿应用经验, MES 连线智能大数据分析经验。

正业科技检测专家——铜厚测试仪系列, 实现不同厚度、在线与离线的铜厚检测, 以硬核实力助力线路板品质提升。